

2026-2032年中国芯粒（Chiplet）市场竞争格局与投资机会研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2026-2032年中国芯粒（Chiplet）市场竞争格局与投资机会研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/report/W45043WQFE.html>

【报告价格】纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

【出版日期】2026-04-20

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明: 《2026-2032年中国芯粒 (Chiplet) 市场竞争格局与投资机会研究报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制, 全面剖析了中国芯粒 (Chiplet) 市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议, 规避市场风险, 全面掌握行业动态。

第一章芯粒 (Chiplet) 产业相关概述1.1 芯片封测相关介绍1.1.1 芯片封测概念界定1.1.2 芯片封装基本介绍1.1.3 芯片测试主要内容1.1.4 芯片封装技术迭代1.2 芯粒 (Chiplet) 基本介绍1.2.1 芯粒基本概念1.2.2 芯粒发展优势1.2.3 与SoC技术对比1.3 芯粒 (Chiplet) 技术分析1.3.1 Chiplet集成技术1.3.2 Chiplet互连技术1.3.3 Chiplet封装技术第二章2021-2025年Chiplet产业发展综合分析2.1 Chiplet产业发展背景2.1.1 中国芯片市场规模2.1.2 中国芯片产量规模2.1.3 中国芯片产业结构2.1.4 中国芯片贸易状况2.1.5 中美芯片战的影响2.2 Chiplet产业发展综述2.2.1 Chiplet芯片设计流程2.2.2 主流Chiplet设计方案2.2.3 Chiplet技术标准发布2.2.4 Chiplet市场参与主体2.3 Chiplet产业运行状况2.3.1 Chiplet市场规模分析2.3.2 Chiplet器件销售收入2.3.3 Chiplet市场需求分析2.3.4 Chiplet企业产品布局2.3.5 Chiplet封装方案布局2.4 Chiplet产业生态圈构建分析2.4.1 UCle产业联盟成立2.4.2 通用处理器企业布局2.4.3 云厂商融入Chiplet生态2.4.4 生态标准需持续完善第三章2021-2025年中国芯片封测行业发展分析3.1 中国芯片封测行业发展综述3.1.1 行业重要地位3.1.2 行业发展特征3.1.3 行业技术水平3.1.4 行业利润空间3.2 中国芯片测封行业运行状况3.2.1 市场规模状况3.2.2 市场竞争格局3.2.3 企业市场份额3.2.4 封装价格状况3.3 中国先进封装行业发展分析3.3.1 行业发展优势3.3.2 市场规模状况3.3.3 市场竞争格局3.3.4 行业SWOT分析3.3.5 行业发展建议3.4 中国芯片封测行业趋势预测趋势3.4.1 测封行业趋势预测3.4.2 封装技术发展趋势3.4.3 先进封装趋势预测3.4.4 先进封装发展方向第四章2021-2025年半导体IP产业发展分析4.1 半导体IP产业基本概念4.1.1 产业发展地位4.1.2 产业基本概念4.1.3 产业主要分类4.1.4 产业技术背景4.1.5 产业影响分析4.2 半导体IP产业运行状况4.2.1 产业发展历程4.2.2 市场规模状况4.2.3 细分市场发展4.2.4 产品结构占比4.2.5 市场竞争格局4.2.6 市场需求分析4.2.7 商业模式分析4.2.8 行业收购情况4.3 半导体IP产业前景展望4.3.1 行业发展机遇4.3.2 行业需求前景4.3.3 行业发展趋势第五章2021-2025年EDA行业发展分析5.1 全球EDA行业发展状况5.1.1 行业基本概念5.1.2 行业发展历程5.1.3 市场规模状况5.1.4 产品构成情况5.1.5 区域分布状况5.1.6 市场竞争格局5.2 中国EDA行业发展综述5.2.1 行业发展历程5.2.2 产业链条剖析5.2.3 行业制约因素5.2.4 行业进入壁垒5.2.5 行业发展建议5.3 中国EDA行业运行状况5.3.1 行业支持政策5.3.2 市场规模状况5.3.3 行业人才情况5.3.4 市场竞争格局5.3.5 行业投资状况5.4 中国EDA行业趋势预测展望5.4.1 行业发展机遇5.4.2 行业趋势预测5.4.3 行业发展趋势第六章2021-2025年国际Chiplet产业重点企

业经营状况分析6.1 超威半导体（AMD）6.1.1 企业发展概况6.1.2 企业经营状况分析6.1.3 企业经营状况分析6.2 英特尔（Intel）6.2.1 企业发展概况6.2.2 企业经营状况分析6.3 台湾集成电路制造股份有限公司6.3.1 企业发展概况6.3.2 企业经营状况分析第七章中国Chiplet产业重点企业经营状况分析7.1 芯原微电子（上海）股份有限公司7.1.1 企业概况7.1.2 企业优势分析7.1.3 产品/服务特色7.1.4 公司经营状况7.1.5 公司发展规划7.2 江苏长电科技股份有限公司7.2.1 企业概况7.2.2 企业优势分析7.2.3 产品/服务特色7.2.4 公司经营状况7.2.5 公司发展规划7.3 天水华天科技股份有限公司7.3.1 企业概况7.3.2 企业优势分析7.3.3 产品/服务特色7.3.4 公司经营状况7.3.5 公司发展规划7.4 通富微电子股份有限公司7.4.1 企业概况7.4.2 企业优势分析7.4.3 产品/服务特色7.4.4 公司经营状况7.4.5 公司发展规划7.5 中科寒武纪科技股份有限公司7.5.1 企业概况7.5.2 企业优势分析7.5.3 产品/服务特色7.5.4 公司经营状况7.5.5 公司发展规划7.6 北京华大九天科技股份有限公司7.6.1 企业概况7.6.2 企业优势分析7.6.3 产品/服务特色7.6.4 公司经营状况7.6.5 公司发展规划第八章中国Chiplet产业典型相关投资项目深度解析8.1 集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目8.1.1 项目基本概况8.1.2 项目投资必要性8.1.3 项目投资可行性8.1.4 项目投资概算8.1.5 项目经济效益8.2 高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目8.2.1 项目基本概况8.2.2 项目投资必要性8.2.3 项目投资可行性8.2.4 项目投资概算8.2.5 项目进度安排8.3 高性能模拟IP建设平台8.3.1 项目基本概况8.3.2 项目投资可行性8.3.3 项目投资概算8.3.4 项目进度安排第九章对2026-2032年中国Chiplet产业投资分析及趋势预测分析9.1 中国Chiplet产业投资分析9.1.1 企业融资动态9.1.2 投资机会分析9.1.3 投资前景提示9.2 中国Chiplet产业趋势预测9.2.1 行业发展机遇9.2.2 产业发展展望图表目录图表 集成电路封装实现的四大功能图表 集成电路测试的主要内容图表 集成电路测试可分为晶圆测试和成品测试图表 集成电路封装技术发展阶段图表 Chiplet内部结构图表 Chiplet技术主要功能分析图表 服务器CPU、GPU裸Die尺寸逐渐增大图表 晶圆利用效率和芯片良率随着芯片面积缩小而提升图表 基于7nm工艺的传统方案及Chiplet方案下良率及合计制造成本对比图表 SoC技术与Chiplet技术关系示意图图表 Chiplet及单片SoC方案环节对比图表 水平和垂直方向集成的Chiplet的结构图表 Chiplet中SerDes互连电路结构图表 Chiplet并行互连电路结构图表 当前Chiplet间主要互连方案比较图表 先进封装技术对比图表 主流Chiplet底层封装技术图表 2021-2025年中国集成电路产业销售额及增速图表 2021-2025年中国集成电路产量统计图图表 2021-2025年中国集成电路产业结构图表 2021-2025年中国集成电路进口数量及增速图表 2021-2025年中国集成电路进口金额及增速图表 Chiplet芯片设计流程图表 主流Chiplet设计方案图表 中国Chiplet产业主要参与者介绍更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/W45043WQFE.html>